

电子

周跟踪 (20230717-20230723)

领先大市-A(首次)

——台积电下调 2023 年营收指引

2023 年 7 月 25 日

行业研究/行业周报

电子行业近一年市场表现



资料来源：最闻

相关报告：

【山证半导体】破晓钟声铺浩渺，AI 浪潮赋新篇——关注周期视角下的复苏迹象-山西证券半导体行业专题 2023.7.17

分析师：

高宇洋

执业登记编码：S0760523050002

邮箱：gaoyuyang@sxzq.com

徐怡然

执业登记编码：S0760522050001

邮箱：xuyiran@sxzq.com

投资要点

➢ **市场整体：**本周（2023.7.17-2023.7.23）市场整体下跌，上证指数跌 2.16%，深圳成指跌 2.44%，创业板指数跌 2.74%，科创 50 跌 3.63%，申万电子跌 4.56%，Wind 半导体跌 4.05%，费城半导体指数跌 1.37%，台湾半导体指数跌 4.15%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为**集成电路封测（2.81%）、模拟芯片设计（0.15%）、电子化学品 II（-1.94%）**，周涨跌幅靠后的三大细分板块为**半导体设备（-8.33%）、消费电子（-6.96%）、半导体材料（-6.00%）**。从个股情况看，涨幅前五为：**杰美特（31.64%）、甬矽电子（25.32%）、金龙机电（21.95%）、联动科技（15.31%）、汇顶科技（14.70%）**；跌幅前五为：**东晶电子（-24.62%）、商络电子（-22.19%）、海光信息（-21.68%）、满昆科技（-21.63%）、恒烁股份（-21.13%）**。

➢ **行业新闻：**台积电 Q3 财测不及预期，全年收入指引下调。台积电公布第二季度业绩，第二季度收入为 156.8 亿美元，按新台币计算环比下降 5.5%，按美元计算环比下降 6.2%。毛利率环比下降 2.2 个百分点至 54.1%。由于中日需求低于预期，预计第三季度收入将在 167 亿美元至 175 亿美元之间，中值 171 亿美元，环比增长 9%；毛利率预计在 51.5%到 53.5%之间。台积电补充称，预计其 2023 年资本支出将处于此前 320 亿美元至 360 亿美元指引区间的低端。

➢ **重要公告：**【聚灿光电】7 月 19 日发布 2023 半年报，报告显示营业收入 1,199,068,519.95 元，比上年同期增 19.21%；归母净利润 25,072,506.74 元，比上年同期减 41.59%。【全志科技】7 月 18 日发布业绩预告，预计 2023 上半年归母净利润亏损:1,000 万元 - 2,000 万元，上年同期盈利:20,303.24 万元。【微导纳米】7 月 18 日发布业绩预告，预计 2023 上半年归母净利润为 6,200.00 万元到 7,500.00 万元，与上年同期相比实现扭亏为盈，同比增加 10,125.03 万元到 11,425.03 万元。【珠海冠宇】7 月 20 日发布业绩预告，预计 2023 年上半年营业收入人民币 530,000.00 万元至 560,000.00 万元，同比减少 7.62%至 2.39%。归母净利润 12,000.00 万元至 15,000.00 万元，同比增加 92.28%至 140.34%。

风险提示

➢ 下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。



目录

1. 行情回顾.....	4
1.1 市场整体行情.....	4
1.2 细分板块行情.....	4
1.2.1 涨跌幅.....	4
1.2.2 估值.....	5
1.3 个股公司行情.....	6
1.4 大厂景气度.....	6
2. 数据跟踪.....	8
3. 新闻公告.....	12
3.1 重大事项.....	12
3.2 行业新闻.....	13
3.3 公司公告.....	13
4. 风险提示.....	14

图表目录

图 1: 主要大盘和电子指数周涨跌幅.....	4
图 2: 周涨跌幅集成电路封测、模拟芯片设计、电子化学品 II 月表现领先.....	4
图 3: 月涨跌幅集成电路封测、模拟芯片设计、电子化学品 II 月表现领先.....	5
图 4: 年涨跌幅集成电路封测、消费电子、光学光电子年初至今表现领先.....	5
图 5: 多数板块当前 P/E 低于历史平均水平.....	5
图 6: 多数板块当前 P/B 低于历史平均水平.....	5
图 7: 本周个股涨幅前五.....	6
图 8: 本周个股跌幅前五.....	6

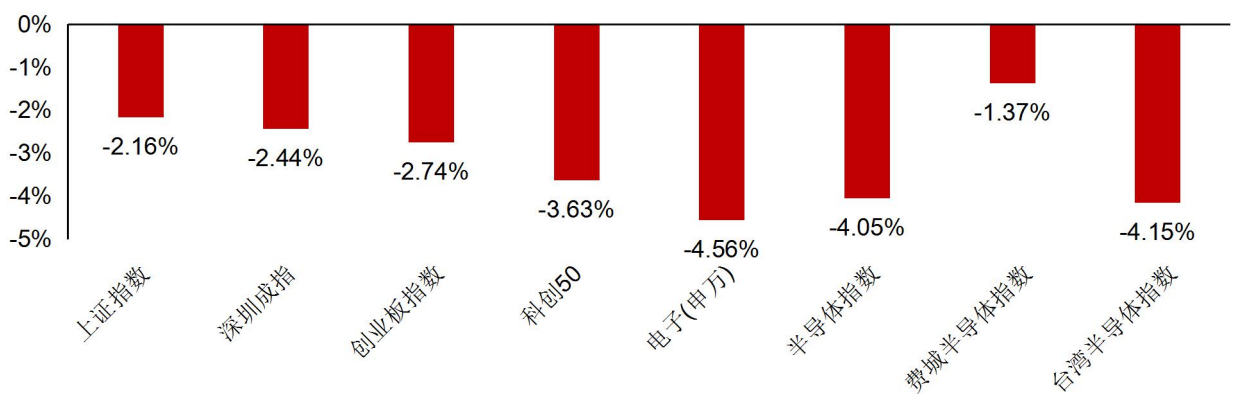
图 9: 全球半导体月度销售额及增速.....	8
图 10: 分地区半导体销售额.....	8
图 11: 中国集成电路行业进口情况.....	8
图 12: 中国集成电路行业出口情况.....	8
图 13: 中国大陆半导体设备销售额.....	8
图 14: 北美半导体设备销售额.....	8
图 15: 日本半导体设备销售额.....	9
图 16: 全球硅片出货面积.....	9
图 17: NAND 现货平均价.....	9
图 18: DRAM 现货均价.....	9
图 19: 半导体封装材料进口情况.....	9
图 20: 半导体封装材料出口情况.....	9
图 21: 半导体封装材料进出口均价.....	10
图 22: 晶圆厂稼动率 (%)	10
图 23: 晶圆厂 ASP (美元/片)	10
表 1: 大厂最新指引.....	6
表 2: 主要半导体产品货期.....	11
表 3: 主要半导体公司存货周转天数.....	11
表 4: 主要半导体公司毛利率情况.....	12
表 5: 本周重大事项.....	12
表 6: 本周重要行业新闻.....	13
表 7: 本周重要公司公告.....	13

1. 行情回顾

1.1 市场整体行情

本周(2023.7.17-2023.7.23)市场整体下跌,上证指数跌 2.16%,深圳成指跌 2.44%,创业板指数跌 2.74%,科创 50 跌 3.63%,申万电子指数跌 4.56%,Wind 半导体指数跌 4.05%,费城半导体指数跌 1.37%,台湾半导体指数跌 4.15%。

图 1: 主要大盘和电子指数周涨跌幅

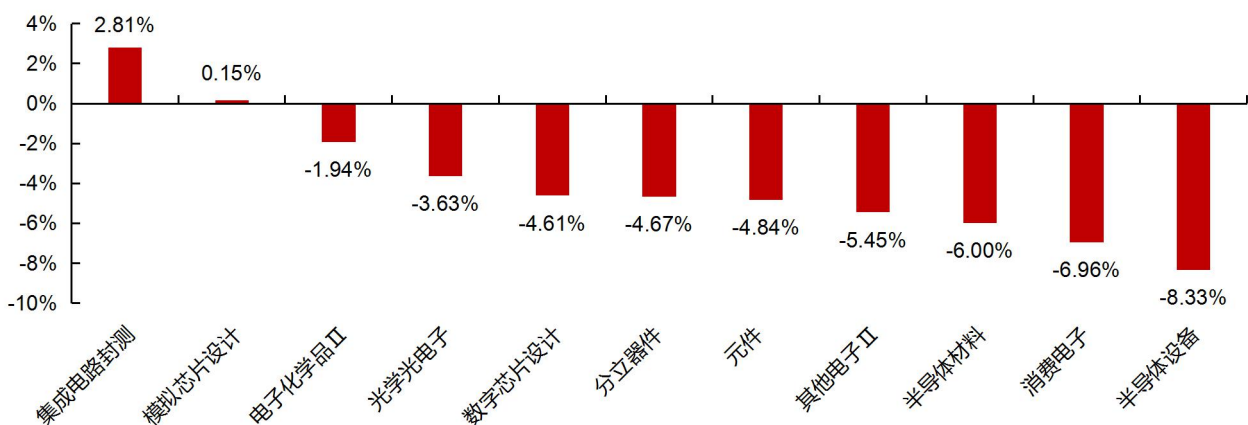


资料来源: Wind, 山西证券研究所

1.2 细分板块行情

1.2.1 涨跌幅

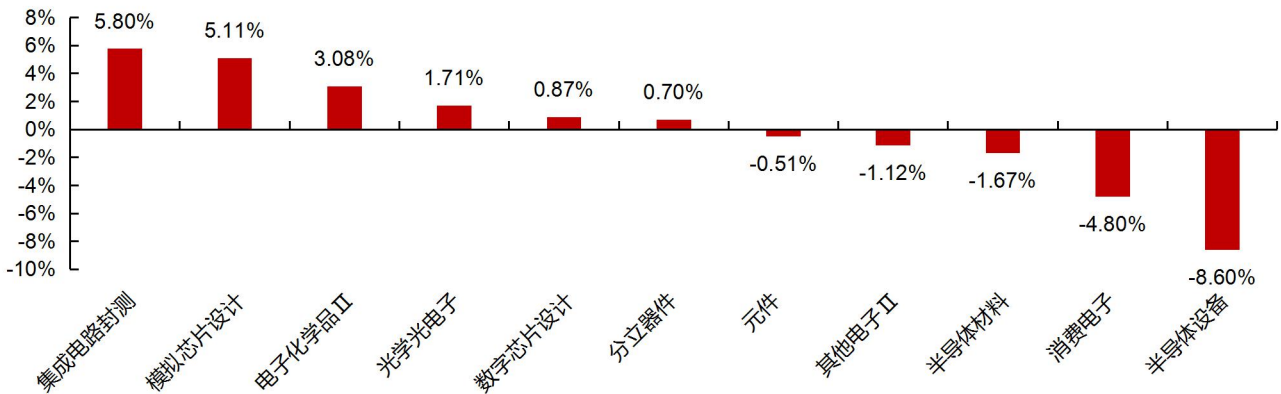
图 2: 周涨跌幅集成电路封测、模拟芯片设计、电子化学品 II 表现领先



资料来源: Wind, 山西证券研究所

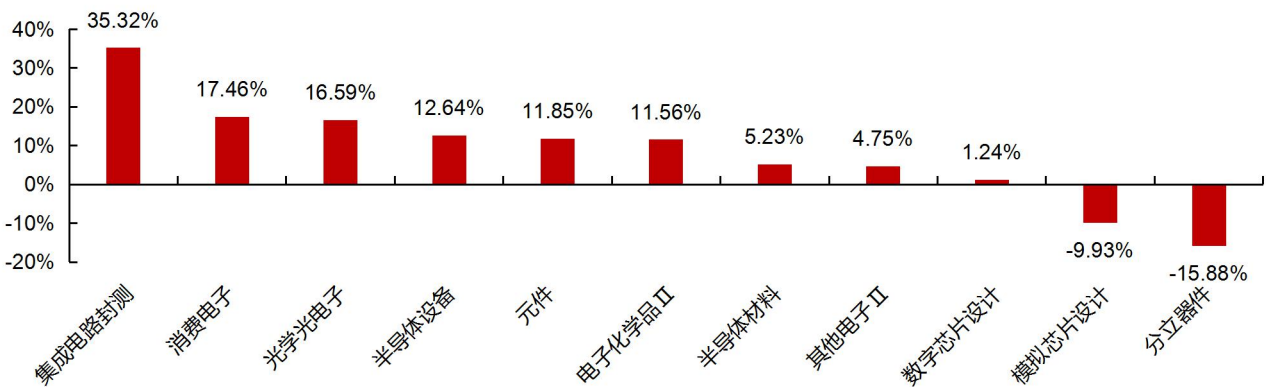


图 3：月涨跌幅集成电路封测、模拟芯片设计、电子化学品 II 表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

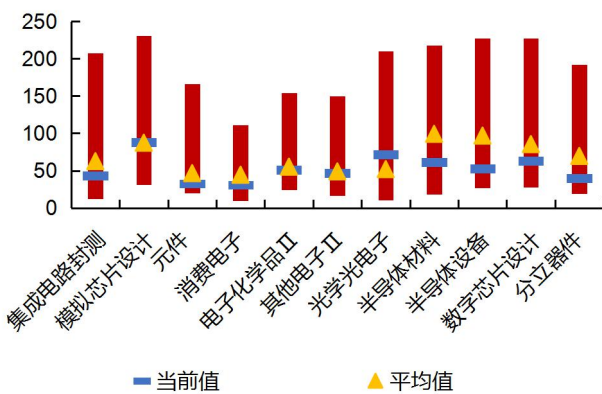
图 4：年涨跌幅集成电路封测、消费电子、光学光电子表现领先



资料来源：Wind，山西证券研究所

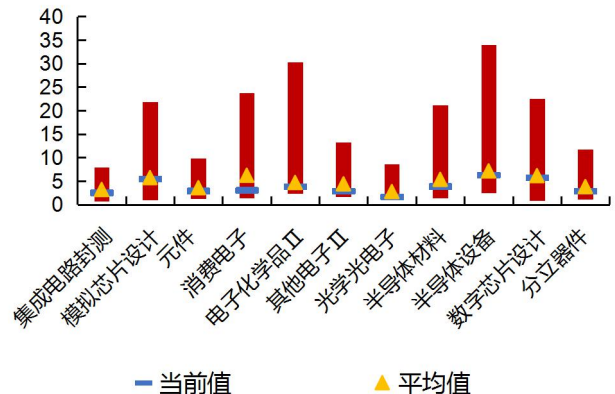
1.2.2 估值

图 5：多数板块当前 P/E 低于历史平均水平



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 6：多数板块当前 P/B 低于历史平均水平

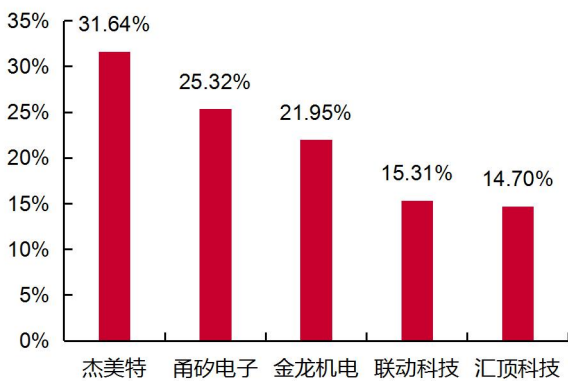


资料来源：Wind，山西证券研究所

1.3 个股公司行情

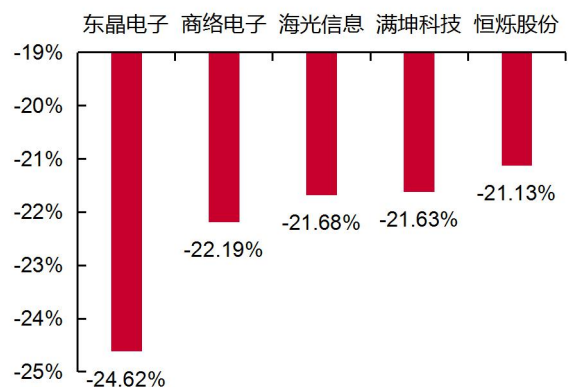
从个股情况看，杰美特、甬矽电子、金龙机电、联动科技、汇顶科技涨幅领先，涨幅分别为 31.64%、25.32%、21.95%、15.31%、14.70%。东晶电子、商络电子、海光信息、满坤科技、恒烁股份跌幅居前，跌幅分别为-24.62%、-22.19%、-21.68%、-21.63%、-21.13%。

图 7：本周个股涨幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

图 8：本周个股跌幅前五



资料来源：Wind，山西证券研究所

1.4 大厂景气度

表 1：大厂最新指引

板块	公司	财年	时期	景气度
存储	美光	23Q3	23.3-23.6	Q2 业绩符合预期，AI 存储需求高于预期，HBM 客户反应强烈，预计 24 年初量产。DDR5 出货量翻倍，预计 24Q1 销量超过 D4。数据中心 SSD 开始采用 176 层或 232 层 NAND，Q3 推出全球首款 200+层 NAND 数据中心 SSD。PC 销量下滑，预计客户在 2024 年初上量 D5。预计客户库存在 Q3 恢复正常，TAM 需求提升。智能手机销量下滑，单高端机型的内存需求强劲。汽车销量提升，23H2 受益客户库存正常及内容容量增加。工业复苏迹象初显，23H2 需求改善。23 年 DRAM 预期增长 1%-5%，NAND 预期增长 6%-9%。本财季 DRAM 价格环比下滑 10%，NAND 下滑 14%-19%。23 年资本开支为 70 亿美元，同比下滑 40%。DRAM 和 NAND 的晶圆开工率降低至 30%，将持续至 2024 年。
	海力士	23Q1	23.1-23.3	23Q1 净亏环比收窄，DRAM ASP 环比下滑 15%-19%，NAND ASP 环比下滑 10%。游戏 PC 销量增加带动存储需求，旗舰机对高性能产品需求增加，AI 发展对 HDM 需求提升。预计 23 年 DRAM 收入增长 4%-9%，NAND 收入增长 14%-19%，23 年资本开支同比下降 50%，预计下半年市场环境有所改善。
MCU	NXP	23Q1	23.1-23.3	23Q1 营收高于指引中值，毛利率为 58.2%，高于指引中值。汽车业务环比增长 1%，同比增长 17%；工业领域环比下滑 17%，同比下滑 26%；手机领域环比下滑 36%，同比下滑 35%；通信业务同比增加 7%，环比增加 7%。23Q2 营收指引中值 32 亿美元，2021-2024 年，预计营收 CAGR 为 8%-12%，汽车业务 CAGR 为 9%-14%，工业领域 CAGR 为 9%-14%，手机业务 CAGR 为 8%-10%，通信领域 CAGR 为 2%-6%，资本开支 CAGR 为 6%-8%。
	ST	23Q1	23.1-23.3	23Q1 营收高于指引中值，汽车和工业领域好于预期，成为 23 年主要增长动力。预计 23Q2 营收 42.8 亿美元，同比增加 11.5%，环比增加 0.8%，毛利率指引 49%，环比下滑 0.7%。23 年营收范围为 170 亿-178 亿，同比增加 5%-10%。2023 年资本开支规划为 40 亿美元

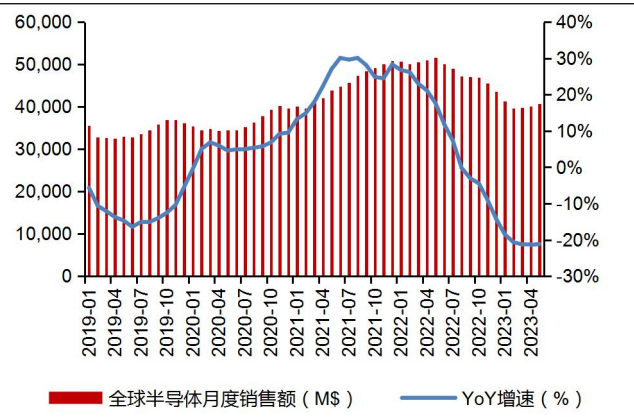


	微芯	23 年	22.4-23.3	23 年强劲客户需求超过预期, 持续增加资本开支用于扩产。2021-2026 年, 营收 CAGR 为 10%-15%
模拟 IC	TI	23Q1	23.1-23.3	23Q1 收入符合预期, 环比下降 6%, 同比下降 11%。Q1 工业基本持平, 汽车业务增长中个位数, 其他业务较为疲软。23Q2 营收指引 41.7 亿-45.3 亿美元。
	ADI	23Q2	23.2-23.4	本季度营收高于指引中值, 营收同比增加 10%, 工业领域同比增长 16%, 汽车同比增长 24%。23Q3 财季收入中值约为 31 亿美元, 工业和汽车开始疲软, 预计环比下降低个位数到中个位数, 通信市场环比下降 10%, 消费市场环比增长。
射频 IC	Qorvo	23Q4	23.2-23.4	本季度业绩超过指引中值, 尽管终端市场疲软, 但大型客户项目支撑未来两个季度发展。预计下个季度营收为 6.2-6.6 亿美元, 毛利率指引为 41.5%。
	博通	23Q2	23.2-23.4	23Q2 营收同比增加 8%, 公司持续布局 AI 领域, 相关收入增长有望超过 20%。23Q3 财季营收指引为 88.5 亿美元, 同比增加约为 5%。
AI 芯片	英伟达	24Q1	23.1-23.3	24Q1 总收入下滑 13%, 达到 71.9 亿美元, 仍高于预期的 65 亿美元。数据中心同比增长 14%, 环比增加 18%; 游戏同比下滑 38%, 环比提升 22%; 汽车业务同比增加 114%, 环比增加 1%。AI 和大模型需求提升, 公司 24Q2 营收指引 110 亿美元。24Q2 财季资本开支 3-3.5 亿美元, 24 财年资本开支 11-13 亿美元。
	AMD	23Q1	23.1-23.3	Q1 业绩好于预期, 在 AI 方面取得重大进展, 数据中心和嵌入式产品营收贡献超过 50%。Q2 数据中心将持续增长, 预计公司营收为 53 亿美元, 同比下滑 19%, 预计数据中心全年继续增长。
功率半导体	英飞凌	23Q2	23.1-23.3	Q2 业绩超预期, AVT 和 GIP 业务亮眼。23Q3 营收指引 40 亿欧元, ATV 部门增速高于 Q2, GIP 部门营收持平, PSS 和 CSS 部门收入下降。23 年全年营收指引 162 亿欧元, 同比增加 14%, 资本开支指引 30 亿欧元。
	安森美	23Q1	23.1-23.3	Q1 业绩高于预期中值, 汽车与工业驱动业绩增长。2021-2025 年, 电源业务 CAGR 为 6%, 传感器 CAGR 为 10%, 汽车业务增速为 17%, 工业领域增速为 7%。23Q2 营收指引 19.75-20.75 亿美元, 毛利率指引 45.5%-47.5%, 环比下降 0.34 pct, 资本开支规划 4.2 亿-4.6 亿美元。
晶圆代工	台积电	23Q2	23.4-23.6	Q2 营收好于预期, 环比下滑 6.2%, 同比下滑 13.7%, 毛利率为 54.1%, 环比下滑 2.2pct。消费电子环比增加 +25%, 汽车电子环比增加 +3%。AI 需求强劲, 目前贡献公司 6% 营收, 未来 5 年 CAGR 达 50%。Q3 营收指引为 167 亿-175 亿美元, 毛利率为 51.5%-53.5%。预计 23 年营收同比下滑 10%, 资本开支为 320 亿-360 亿美元。
	联电	23Q1	23.1-23.3	Q1 业绩符合预期, 毛利率环比下滑 7.4pct, 产能利用率下滑至 70%。23Q2 毛利率指引 35%, 产能利用率略高于 70%, 23 年资本开支约 30 亿美元。
设备	应用材料	23Q2	23.2-23.4	Q2 营收超预期, 同比增加 6%, 环比减少 2%。23Q3 营收指引 61.5 亿美元, 半导体系统营收 45 亿, AGS 营收 14.3 亿。
	泛林半导体	23Q1	23.1-23.3	Q1 营收 38.7 亿美元, 高于预期中值, Q2 营收指引 31 亿美元, 毛利率指引 42.2%-44.2%。23 年 WFE 行业指引 750 亿美元, 内存预计同比下降 50%。
	东京电子	23 年	22.4-23.3	SPE 实现营收 122.4 亿美元, 同比增加 10.9%。23 年半导体市场同比下滑 10%, 2024 年将超过 2022 年水平。预计 2023 年下半年逻辑/晶圆代工开始复苏, 行业收入整年 700-750 亿美元。预计 2024 年半导体行业和 WFE 复苏实现进一步增长。公司 24 财年营收指引为 123 亿美元, 同比下滑 23%。24 财年资本开支规划 8.8 亿美元。
	AMSL	23Q1	23.1-23.3	资料来源: 山西证券研究所 Q1 收入超预期, YoY+90.9%, QoQ+4.9%。23Q2 营收指引 65-70 亿欧元, 毛利率指引 50%-51%, 23 年营收指引同比增长 25%。2025 年营收指引 300-400 亿欧元, 2030 年指引 440-600 亿欧元。

资料来源: 各公司官网, 山西证券研究所

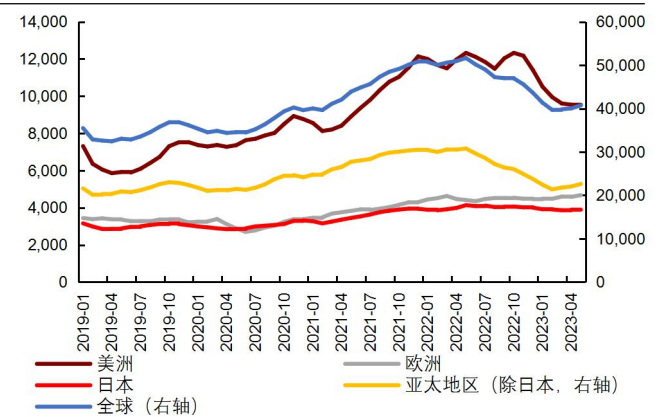
2. 数据跟踪

图 9：全球半导体月度销售额及增速



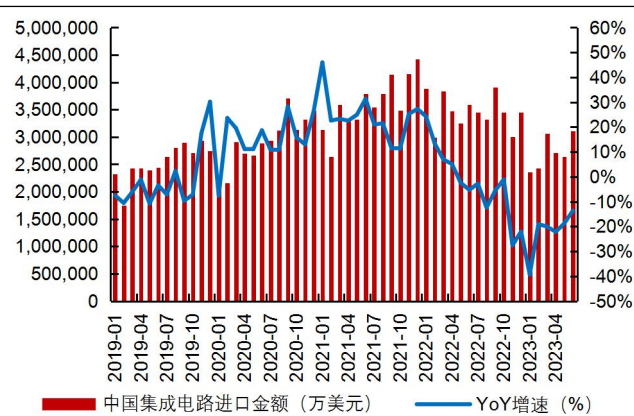
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 10：分地区半导体销售额



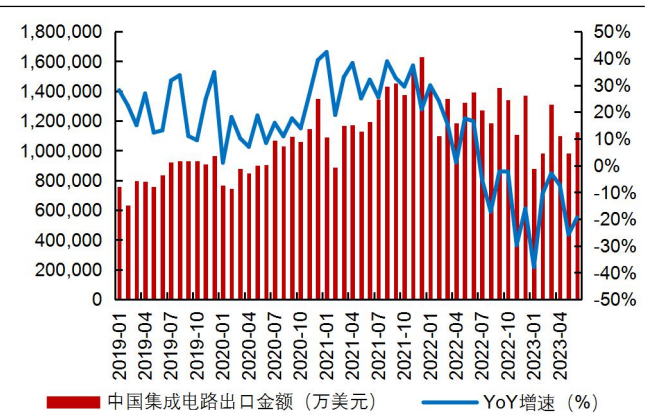
资料来源：WSTS，山西证券研究所

图 11：中国集成电路行业进口情况



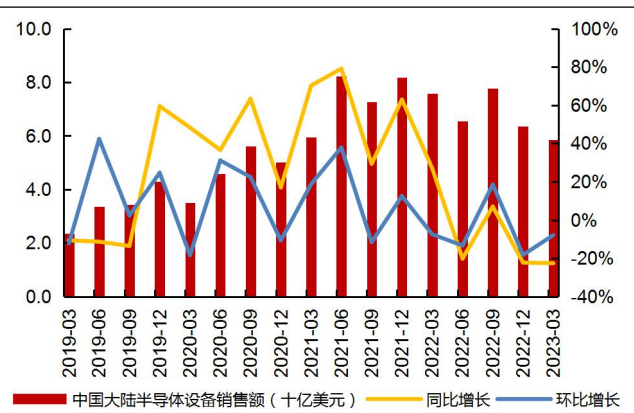
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 12：中国集成电路行业出口情况



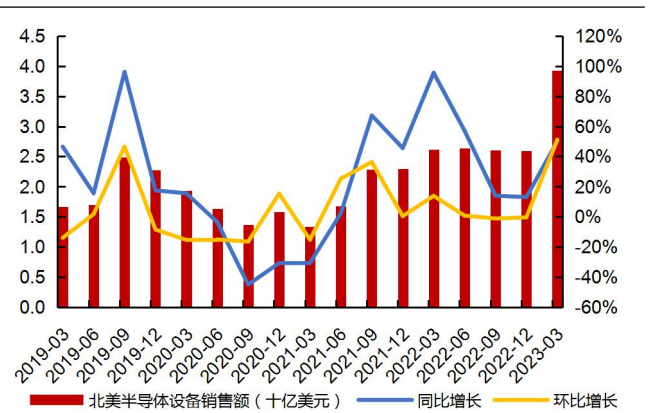
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 13：中国大陆半导体设备销售额



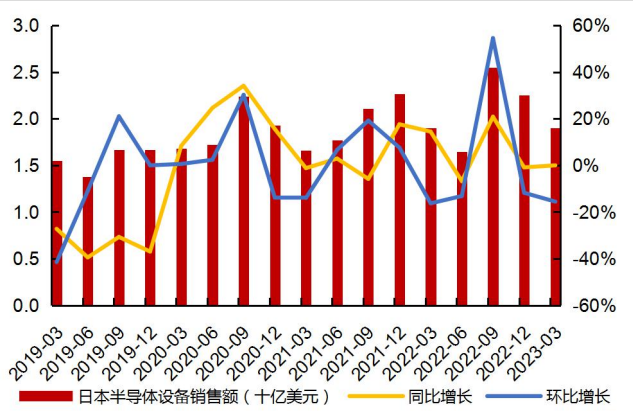
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 14：北美半导体设备销售额



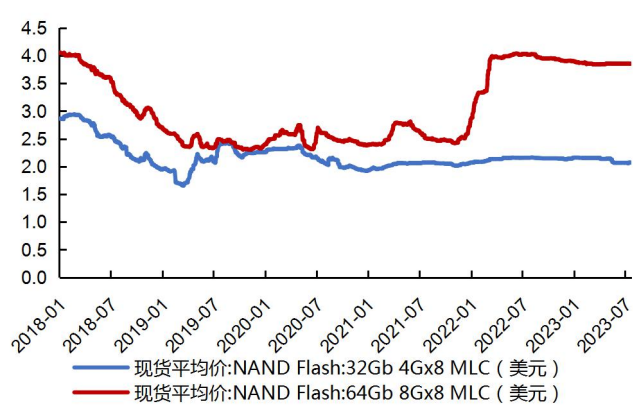
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 15: 日本半导体设备销售额



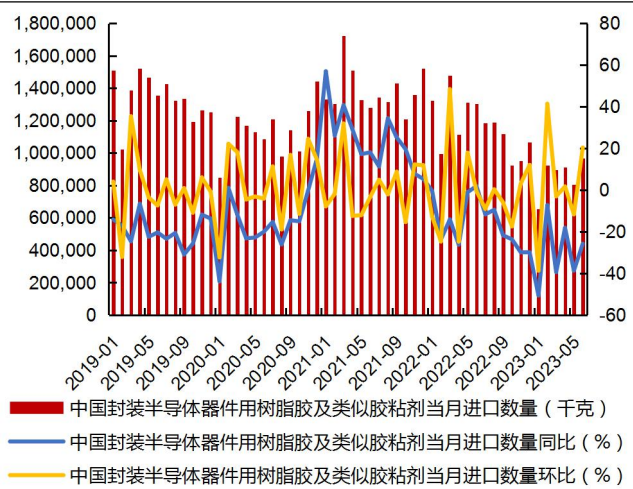
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 17: NAND 现货平均价



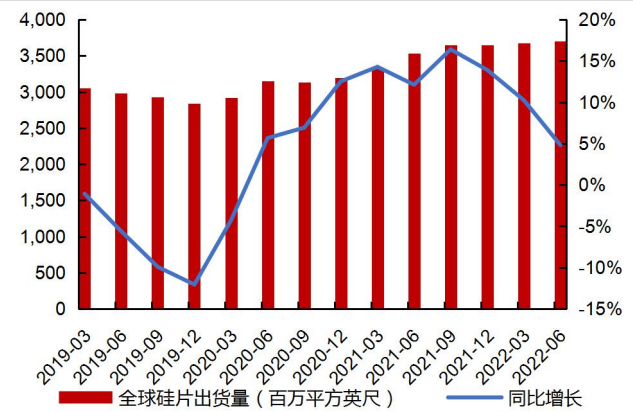
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 19: 半导体封装材料进口情况



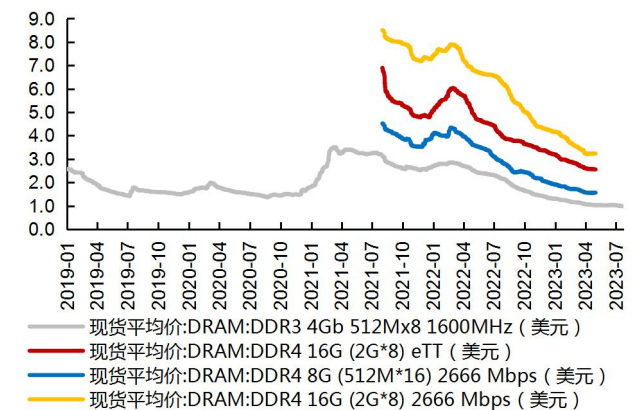
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 16: 全球硅片出货面积



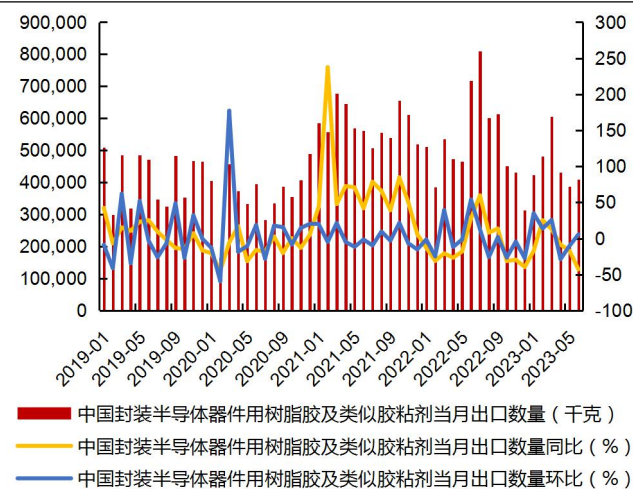
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 18: DRAM 现货均价



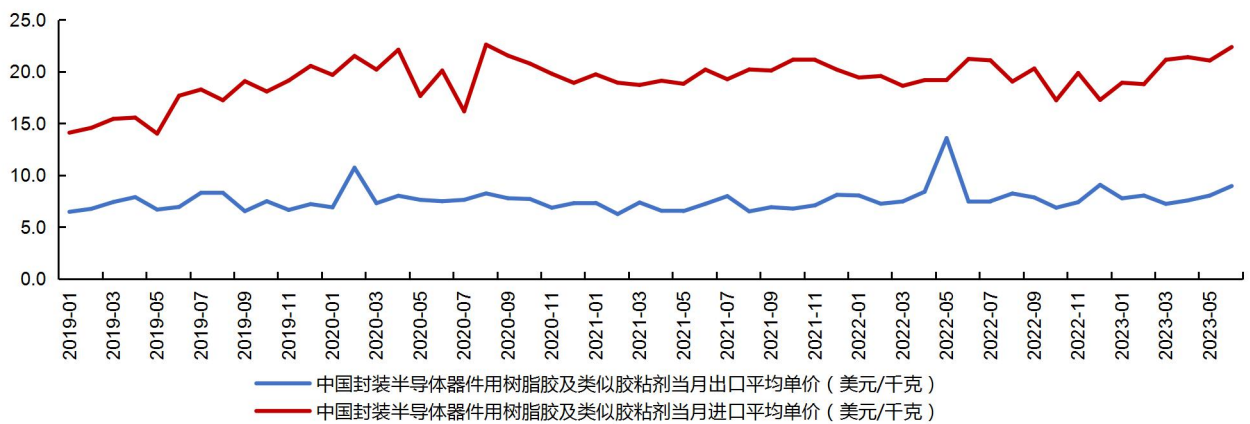
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 20: 半导体封装材料出口情况



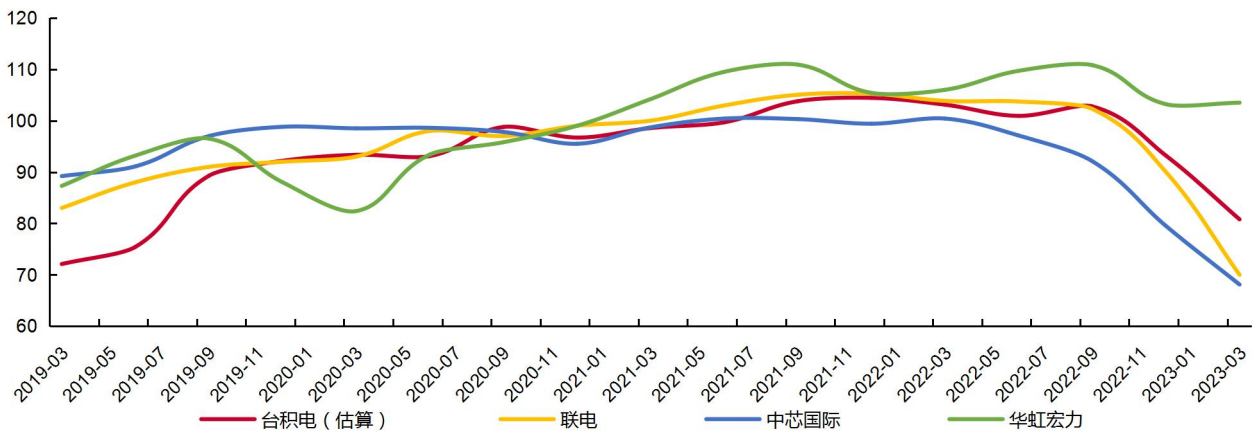
资料来源: Wind, 山西证券研究所

图 21：半导体封装材料进出口均价



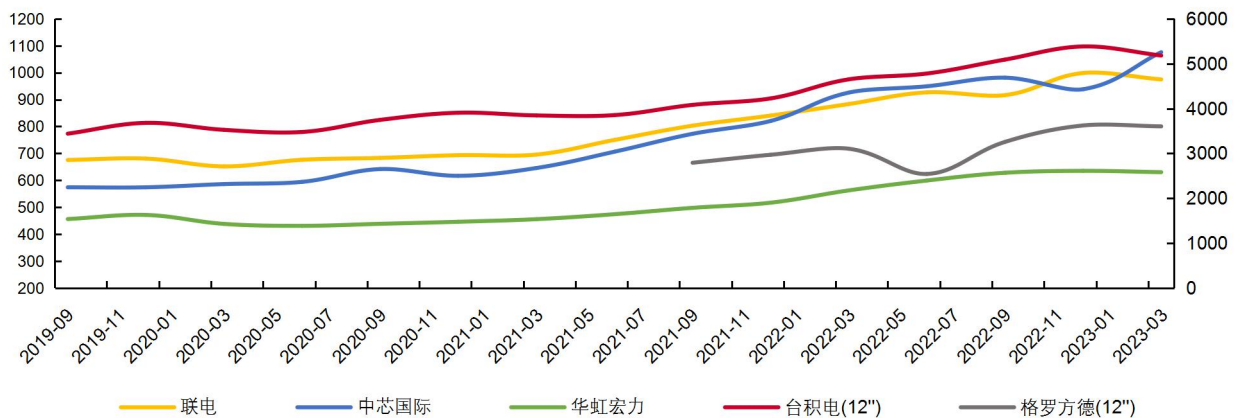
资料来源：Wind，山西证券研究所

图 22：晶圆厂稼动率（%）



资料来源：公司公告，山西证券研究所

图 23：晶圆厂 ASP（美元/片）



资料来源：公司公告，山西证券研究所

表 2：主要半导体产品货期

低压 MOSFET 货期 (周)				高压 MOSFET 货期 (周)				IGBT 货期 (周)			
供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势
Infineon	20-52	↘	↔	Infineon	50-54	↔	↔	Fairchild	39-52	↔	↔
Diodes	26-54	↘	↔	On Semi	36-52	↔	↗	Infineon	39-50	↔	↔
On Semi	36-52	↘	↗	IXYS	50-54	↔	↔	STMicro	47-52	↔	↔
Nexperia	47-52	↔	↔	STMicro	47-52	↔	↔				
8 位 MCU 货期 (周)				32 位 MCU 货期 (周)				FPGA 货期 (周)			
供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势
NXP	35-52	↘	↔	NXP	26-52	↘	↔	Lattice	28-42	↘	↔
Microchip	36-52+	↘	↔	Microchip	36-52+	↘	↔	Microsemi	32-42	↘	↔
Renesas	18-24	↘	↔	Renesas	18-24	↘	↔				
传感器货期 (周)				信号链 (放大器和数据转换器) 货期 (周)				NAND 闪存货期 (周)			
供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势	供应商	2Q23	货期趋势	价格趋势
Melexis	35-40	↘	↗	On Semi	26-42	↘	↔	Macronix	8-12	↔	SMA
NXP	16-52	↗	↗	Renesas	36-40	↔	↔	Alliance Memory	8-24	↘	↔
Infineon	18-52	↔	↗								

资料来源：富昌电子，山西证券研究所

表 3：主要半导体公司存货周转天数

海外功率公司			国内功率公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Infineon	143		斯达半导	150	
On Semi	148		士兰微	189	
			华润微	115	
海外模拟芯片公司			国内模拟芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
TI	179		圣邦股份	286	
ADI	128		思瑞浦	219	
海外存储芯片公司			国内存储芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Micron	167		北京君正	311	
Samsung	104		兆易创新	238	
			澜起科技	358	
海外 MCU 芯片公司			国内 MCU 芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
NXP	125		北京君正	311	
Microchip	157		兆易创新	238	
Renesas	106		中微半导	487	
国内设备公司			国内被动元件公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
北方华创	570		风华高科	72	
芯源微	773		三环集团	231	
长川科技	1070		法拉电子	112	
中微公司	492		泰晶科技	114	
国内光电公司			国内消费电子公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
三安光电	218		歌尔股份	60	
乾照光电	104		工业富联	70	
聚灿光电	51		立讯精密	67	
京东方A	60				

资料来源：Wind，山西证券研究所

表 4：主要半导体公司毛利率情况

海外功率公司			国内功率公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Infineon	46.90%		斯达半导	36.43%	
On Semi	46.82%		士兰微	26.17%	
			华润微	34.80%	
海外模拟芯片公司			国内模拟芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
TI	65.38%		圣邦股份	52.66%	
ADI	65.72%		思瑞浦	57.85%	
海外存储芯片公司			国内存储芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
Micron	-17.80%		北京君正	37.08%	
Samsung	27.83%		兆易创新	38.25%	
			澜起科技	53.29%	
海外MCU芯片公司			国内MCU芯片公司		
供应商	latest Q	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
NXP	56.71%		北京君正	37.08%	
Microchip	68.05%		兆易创新	38.25%	
Renesas	55.68%		中微半导	21.86%	
国内设备公司			国内被动元件公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
北方华创	41.18%		风华高科	11.08%	
芯源微	45.31%		三环集团	39.41%	
长川科技	56.00%		法拉电子	37.65%	
中微公司	45.87%		泰晶科技	23.64%	
			台湾晶技	34.80%	
国内光电公司			国内消费电子公司		
供应商	1Q23	趋势迷你图	供应商	1Q23	趋势迷你图
三安光电	16.87%		歌尔股份	6.98%	
乾照光电	4.38%		工业富联	7.36%	
聚灿光电	8.61%		立讯精密	10.03%	
京东方A	6.84%				

资料来源：Wind，山西证券研究所

3. 新闻公告

3.1 重大事项

表 5：本周重大事项

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2023 年 7 月 17 日		华特气体、恒玄科技		纳芯微	必创科技
2023 年 7 月 18 日	龙芯中科	拓荆科技			
2023 年 7 月 19 日		思科瑞			
2023 年 7 月 20 日		五方光电、瀛通通讯	厦门信达		
2023 年 7 月 21 日		炬光科技			

时间	拟增持	拟减持	拟回购	拟并购	拟定增
2023年7月22日					
2023年7月23日				致尚科技	

资料来源：Wind，山西证券研究所

3.2 行业新闻

表 6：本周重要行业新闻

时间	内容	来源
2023年7月17日	美三大芯片巨头（英特尔、英伟达、高通）首席执行官在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。	环球网
2023年7月19日	ASML 公布了 2023 年第二季度业绩，第二季度净销售额 69 亿欧元，毛利率 51.3%，净利润 19 亿欧元，净预订额为 45 亿欧元。ASML 上调财年指引，预计 2023 年第三季度净销售额在 65 亿至 70 亿欧元之间，增幅迈向 30%，毛利率约为 50%。	法说会
2023年7月20日	台积电公布第二季度业绩，第二季度收入为 156.8 亿美元，按新台币计算环比下降 5.5%，按美元计算环比下降 6.2%。毛利率环比下降 2.2 个百分点至 54.1%。由于中日需求低于预期，预计第三季度收入将在 167 亿美元至 175 亿美元之间，中值 171 美元，环比增长 9%；毛利率预计在 51.5%到 53.5%之间。	法说会
2023年7月21日	国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知，加快推动电子产品升级换代、大力支持电子产品下乡、打通电子产品回收渠道、优化电子产品消费环境。发展改革委将会同有关部门加强统筹协调，推动政策尽快落地见效，促进电子产品消费持续恢复。	新华社
2023年7月21日	AMD 首席执行官苏姿丰表示，除了台积电之外，AMD 还会考虑其他代工厂商来生产 AMD 设计的芯片，以确保供应链的弹性。	财联社

资料来源：环球网、法说会、新华社、财联社，山西证券研究所

3.3 公司公告

表 7：本周重要公司公告

公司	时间	公告类型	公告摘要
中芯国际	7月17日	人事变动	高永岗博士因工作调整，辞任本公司董事长。本公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士获委任为本公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席。
沃格光电	7月17日	投资变动	关于设立江西德虹显示技术有限公司投资新建“玻璃基材的 Mini/MicroLED 基板生产项目”进展发生调整。项目预计土建费用 16,776.35 万元，设备购置及安装费 111,781.17 万元，基本预备费 6,421.00 万元，铺底流动资金 7,600.00 万元，项目拟总投资金额调整至 142,578.52 万元，实施建成并达产后，预计将实现年产 500 万平方米 MiniLED 玻璃基线路板产能。
纳芯微	7月17日	拟收购	拟与 JINGCAO(曹靖)、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)等 10 名昆腾微的股东收购上述股东持有昆腾微的 33.63%股权。
全志科技	7月18日	业绩预告	预计 2023 上半年归母净利润亏损:1,000 万元 - 2,000 万元，上年同期盈利:20,303.24 万元。
微导纳米	7月18日	业绩预告	预计 2023 上半年归母净利润为 6,200.00 万元到 7,500.00 万元，与上年同期相比实现扭亏为盈，同比增加

公司	时间	公告类型	公告摘要
			10,125.03 万元到 11,425.03 万元。
歌尔股份	7月19日	股权激励	本次激励计划拟授予的股票期权数量为 22,520 万份, 对应的标的股票数量为 22,520 万股, 占截至目前公司股本总额的 6.58%, 其中首次授予股票期权 21,000 万份。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 5,704 人, 激励对象为公司及子公司重要管理骨干、业务骨干。
聚灿光电	7月19日	中报	2023 上半年报告显示营业收入 1,199,068,519.95 元, 比上年同期增 19.21%; 归母净利润 25,072,506.74 元, 比上年同期减 41.59%。
佰维存储	7月19日	对外投资	拟发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%, 募集资金总额不超过 450,000.00 万元 (含本数), 扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目: 惠州佰维先进封装及存储器制造基地扩产建设项目、晶圆级先进封装制造项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。
珠海冠宇	7月20日	业绩预告	预计 2023 年上半年营业收入人民币 530,000.00 万元至 560,000.00 万元, 同比减少 7.62%至 2.39%。归母净利润 12,000.00 万元至 15,000.00 万元, 同比增加 92.28%至 140.34%。
中瓷电子	7月21日	对外投资	设立分公司河北中瓷电子科技股份有限公司石家庄高新区分公司, 设立目的为交割标的资产。
汇顶科技	7月21日	股权激励	本激励计划拟向激励对象授予 19,619,670 份股票期权, 涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股, 占本激励计划公告日公司股本总额 457,993,141 股的 4.28%。本激励计划授予的激励对象总人数为 1,145 人, 包括公司公告本激励计划时在公司或其下属公司任职的核心管理人员及核心技术(业务)骨干。
永新光学	7月21日	股权激励	本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 72.80 万股, 约占本激励计划草案公布日公司股本总额 11,044.95 万股的 0.66%。其中, 首次授予限制性股票 61.80 万股, 约占本激励计划草案公布日公司股本总额 11,044.95 万股的 0.56%, 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 84.89%。本激励计划首次授予激励对象共计 98 人, 包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的高级管理人员、中层管理人员、技术干部及核心骨干员工。
致尚科技	7月23日	收购兼并	致尚科技拟以自有资金人民币 1,100 万元购买玄国栋持有的福可喜玛 11%的股权。本次收购前, 公司已持有福可喜玛 40%股权, 收购完成后, 公司最终合计持有福可喜玛 51%的股权, 福可喜玛将成为公司控股子公司。

资料来源: Wind, 山西证券研究所

4. 风险提示

下游需求回暖不及预期, 技术突破不及预期, 产能瓶颈, 外部制裁升级。

分析师承诺：

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级：因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。（新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级）

评级体系：

——公司评级

- 买入： 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上；
- 增持： 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间；
- 中性： 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间；
- 减持： 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间；
- 卖出： 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市： 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上；
- 同步大市： 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间；
- 落后大市： 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A： 预计波动率小于等于相对基准指数；
- B： 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息，但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期，公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则，公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构；禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人，提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

